

上海市电子电路行业 2026 上半年运行情况及趋势研判

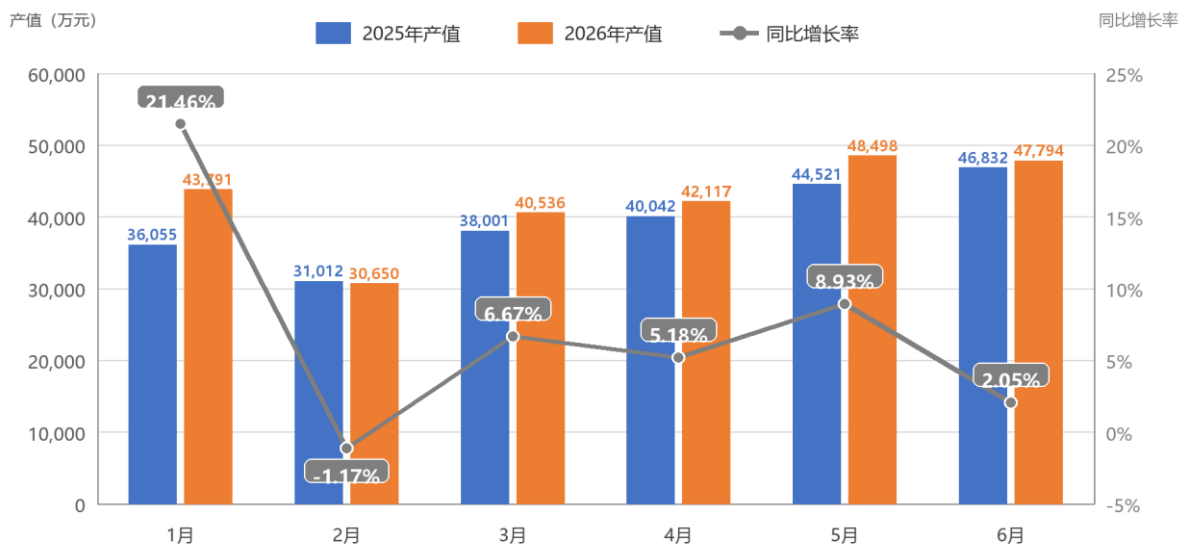
一、2026 上半年行业运行动态

2026 年上半年电子电路行业整体延续增长态势。协会统计企业二季度与上半年合计营收同比均保持增长，进出口贸易增加，贸易差额进一步扩大。上海加快人工智能及算力基础设施建设，人工智能服务器、高速交换机、存储模组和汽车电子等需求继续拉动高多层、高阶 HDI 等高端 PCB 产品；与此同时，存储器供给偏紧、铜价及电子玻纤布等原材料价格上行，行业呈现需求增长与成本压力并存的特征。

（一）PCB 制造企业的运行情况

协会统计的上海地区 PCB 制造企业 2026 年上半年合计营收约 25.34 亿元，同比增长 7.16%；其中二季度合计营收约 13.84 亿元，同比增长 5.34%。7 家企业中 5 家上半年营收实现增长，行业整体保持增长态势，但企业间有所分化。

如图 1-1 所示，2026 年 1—6 月合计产值同比增长 7.16%。分月看，1 月同比增长 21.46%，2 月同比下降 1.17%，3—6 月分别增长 6.67%、5.18%、8.93%和 2.05%；二季度增速较一季度有所放缓，但仍保持正增长。增长主要来自销售面积、平均单价及产量提升，高端算力相关需求对部分企业形成支撑。从企业情况看，美维电子可量产 20—40 层服务器主板，山崎电路板二期智能产线主攻 14—24 层中高多层算力板，奥特斯、美维电子等企业具备高阶 HDI 能力。



数据来源：上海市电子电路行业协会

图 1-1 上海地区 PCB 制造企业 2025-2026 年 1—6 月产值情况

(二) 上海 PCB 进出口情况

根据海关统计在线查询结果，2026 年上半年上海地区印刷电路出口金额为 7.4 亿美元，增长 2.8%。具体来看，出口达 5.4 亿美元，增加 20.0%，进口下降 25.9%，进出口贸易差额进一步扩大。

表 1-2 上海地区 PCB2026 上半年进出口贸易情况（单位：亿美元）

上海	2026 年上半年	2025 年上半年	同比
进出口(亿美元)	7.4	7.2	2.8%
出口(亿美元)	5.4	4.5	20.0%
进口(亿美元)	2	2.7	-25.9%

数据来源：海关总署

从出口国家或地区看，2026 年上半年上海地区 PCB 出口主要集

中于中国台湾、越南、泰国、马来西亚、墨西哥、韩国、印度、日本及菲律宾。中国台湾、越南和泰国占总出口比重分别较 2025 年同期提高 5.0、4.3 和 2.7 个百分点；韩国、印度和马来西亚占比分别下降 3.6、2.2 和 1.4 个百分点。前十市场合计占上海 PCB 出口的 84.1%，出口市场集中度较高。

表 1-3 上海地区 PCB 前十出口国家或地区情况（2026 上半年，单位：美元）

前十出口国家或地区	2026 年上半年出口金额（美元）	2026 年上半年占总出口比例	2025 年上半年占总出口比例	占比差额
中国台湾	92,878,584	17.3%	12.3%	5.0%
越南	68,998,260	12.9%	8.6%	4.3%
中国香港	60,593,163	11.3%	11.2%	0.1%
泰国	56,850,617	10.6%	7.9%	2.7%
马来西亚	44,843,418	8.4%	9.8%	-1.4%
墨西哥	33,750,421	6.3%	6.1%	0.1%
韩国	25,449,269	4.7%	8.3%	-3.6%
印度	25,018,970	4.7%	6.8%	-2.2%
日本	24,808,677	4.6%	5.0%	-0.4%
菲律宾	18,112,947	3.4%	2.4%	1.0%

数据来源：海关统计数据

（三）上游原材料企业的运行情况

2026 年上半年，AI 算力和高速通信需求带动覆铜板、电子级玻纤布、湿电子化学品及特种树脂等材料需求增长。上海企业在高速

覆铜板、低介电电子布、PCB 专用化学品和电子级特种树脂等领域已形成一定配套能力。铜价及部分电子材料价格上行，行业呈现需求增长、产品提价与成本压力并存的特征。

覆铜板企业方面，南亚新材预计 2026 年上半年归母净利润 4.20 亿元至 5.00 亿元，同比增长 381.71%至 473.46%，主要受算力产业链需求旺盛、产品量价齐升和结构优化带动；金安国纪预计归母净利润 7.30 亿元至 8.20 亿元，同比增长 935.75%至 1063.45%，主要受覆铜板及半固化片销量、售价和毛利率上升带动。

电子布和化学品企业方面，宏和科技预计 2026 年上半年归母净利润 3.3168 亿元至 4.0539 亿元，同比增长 280%至 364%，受电子级玻纤布需求及售价上升、特种电子布和超薄布产品占比提高带动。天承科技预计营业收入 3.00 亿元至 3.10 亿元，同比增长 40.75%至 45.44%；归母净利润 6000 万元至 6500 万元，同比增长 63.34%至 76.95%，主要受 PCB 专用湿电子化学品销量增长、产品结构优化和运营效率提升带动。

树脂材料方面，衡封新材于 2026 年 1 月完成近亿元 B 轮融资，由华舆转型升级基金、涌铎投资、临港数科基金、大零号湾策源基金和上海元禾璞华基金联合投资，资金重点用于自有厂房建设和产线扩产。公司已布局安徽蚌埠生产基地，其中一期为 1 万吨电子级酚醛树脂生产线，二期规划建设 1.8 万吨电子级酚醛树脂和 2000 吨电子级环氧树脂生产线，加快电子级特种树脂产能落地和国产化配套。

（四）下游终端产品行业的运行情况

人工智能服务器、高速交换机、存储模组和汽车电子等应用继续推动高多层、高密度互连和高速高频 PCB 需求。随着上海人工智能和算力基础设施建设加快，相关需求向 PCB 及材料端传导，为本地电子电路产业提供了新的需求支撑。从产业链情况看，上海在服务器主板、高阶 HDI、载板及部分关键材料环节已具备一定配套基础。

（五）预测 2026 三季度发展情况

三季度上海电子电路行业预计延续结构性增长态势。AI 服务器、高速通信和汽车电子仍将支撑高端 PCB 需求，但传统消费电子需求恢复程度、原材料价格波动以及外部贸易环境仍存在不确定性。预计行业总体保持平稳增长，企业间分化仍将延续。

二、2026 年上半年 PCB 行业的变化情况

（一）企业投资扩产项目情况

从全国投资情况看，2026 上半年，全球电子电路行业投资热度维持高位，国内扩产动能强于国际。上半年国内 PCB 投资呈项目数量与披露金额均大幅增加；国际方面，上半年项目数量有所回落、但单体项目金额扩大。全球投资热度仍由中国大陆扩产及 AI 算力、材料配套拉动，海外则以东南亚的增资、扩产以及再投资为主。

南亚新材继续围绕高速高频电子电路基材扩充产能。公司公告显示，江西南亚 N6 工厂自 2025 年起陆续投产，2026 年一季度产能

得到较充分释放；拟建高端电子电路基材项目主要面向 M4—M8 等级高速产品，规划年产 720 万张覆铜板和 1600 万米粘结片。

金安国纪持续完善覆铜板产业链布局。公司既有项目包括年产 4800 万米电子级玻纤布项目；2026 年申报的年产 4000 万平方米高等级覆铜板项目拟落地安徽宁国，重点布局高频高速、高耐热、高 Tg 和无卤无铅产品。鉴于项目尚存在审批、建设和市场变化等风险。

（二）企业外迁动向

受客户就近配套、供应链韧性和国际经贸环境变化影响，东南亚等地区仍是 PCB 企业海外产能布局的重要方向。企业在推进海外布局的同时，需要同步完善质量管理、供应商配套、合规经营和本地化服务能力。

海外布局有利于贴近客户和分散区域风险，但也面临建设周期、人才供给、法规税务、文化管理及供应链稳定性等挑战。企业应根据客户结构和订单可持续性审慎安排投资节奏，统筹境内外产能。

上海市电子电路行业协会

2026 年 08 月 06 日